



全世界领先元器件制造商的选择

叠层机

SB - 系列



- 自动堆叠，从料匣自动上料
- 自动分离载带
- 高堆叠压力
- 堆叠周期短
- 适合大批量生产应用
- 定位针或 CCD 视像对准膜片
- 适合大批量生产的 LTCC 应用

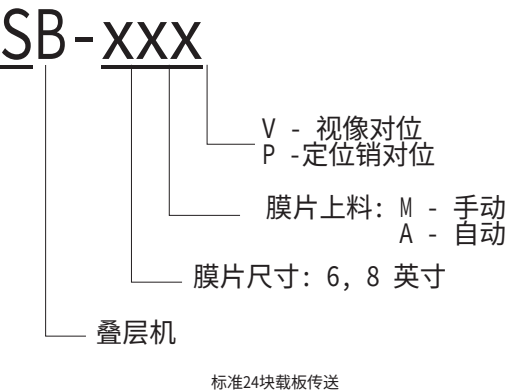
操作简单，高产量

基本特点:

SB 系列自动叠片机设计用于大规模生产电子元器件产品，如 LTCC、HTCC、低层数的压电器件、MLCI 等。最多可同时处理 24 个载板，载板放上料匣中再自动加载到传送带上。载板按照预设程序依次进行传递直到完成堆叠，堆叠后的载板将自动放回料匣中。

- 设备主要由以下部件构成：
- 用于运输载板的特殊形状同步皮带制造的运输轨道。
 - 用于从运输轨道上自动上下料的载盘料匣系统。
 - 料匣系统支持 8 或 16 不同膜带自动上料。
 - 机械定位针或 CCD 视像对准系统。
 - 插入白片以获得更均匀的表面和更高的堆叠层数的加压系统。
 - 叠片后载带分离系统。

技术规格
膜片上料方式：自动从料盒中上料 定位：高精度定位销或者PC视像对位 载板：用于叠层的Keko标准载板或者客户定制载板 叠压面积：最大203 x 203 mm (8 x 8 英寸) 压台：液压方式，也可插入白片以均衡堆叠表面的压力 压力：100 – 420 kN，可调，可选每一层单独编程 温度：最大120 °C (250 °F) (上压台) 时间：可编程 标准循环时间：8 sec. (包含标准 3 sec.压合时间) 操作介面：PLC控制 堆叠参数，或压力，温度，时间等可调 电源：根据客户要求 大概尺寸：L x W x H: 2,8 m (110英寸) x 1,6 m (63英寸) x 1,7 m (67英寸)



*选配和其它需求需单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com